

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

1. Разделение подложек гибридных интегральных схем
и полупроводниковых пластин 4

2. Монтаж подложек ГИС (МСБ) и кристаллов полупроводниковых ИС 10

3. Электромонтажные соединения, пайка, термокомпрессионная
и ультразвуковая сварка 20

4. Способы защиты ИС от внешних воздействий 32

5. Контроль качества при сборке и герметизации ИС 48

6. Современные методы монтажа микроэлектронных изделий 60

7. Качество интегральных схем аппаратуры специального назначения 75

Библиографический список 91

Жаркой Михаил Филиппович

Сборочные процессы в производстве интегральных схем

Редактор *Г.В.Никитина*

Корректор *Л.А.Петрова*

Компьютерная верстка: *Л.Ф.Косин*

Подписано в печать 26.05.2017. Формат 60×

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 5,4. Ти

Балтийский государственный техни

Типография БГТУ

190005, С.-Петербург, 1-я Красн

БИБЛИОТЕКА БГТУ "ВОЕНМЕХ"



00437284